

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2021年12月2日(02.12.2021)



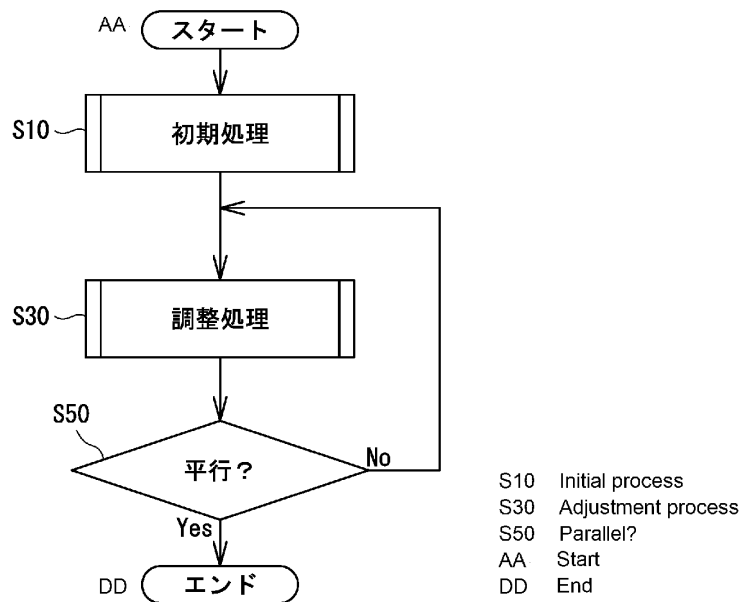
(10) 国際公開番号

WO 2021/241095 A1

- (51) 国際特許分類:
H01L 21/52 (2006.01) **H05K 13/04** (2006.01)
H01L 21/60 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2021/016472
- (22) 国際出願日: 2021年4月23日(23.04.2021)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2020-091570 2020年5月26日(26.05.2020) JP
- (71) 出願人: 株式会社新川(**SHINKAWA LTD.**) [JP/JP]; 〒2088585 東京都武蔵村山市伊奈平 2 丁目 5 1 番地の 1 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 永口 悠二(**EGUCHI Yuji**); 〒2088585 東京都武蔵村山市伊奈平 2 丁目 5 1 番地の 1 株式会社新川内 Tokyo (JP). 瀬山 耕平(**SEYAMA Kohei**); 〒2088585 東京都武蔵村山市伊奈平 2 丁目 5 1 番地の 1 株式会社新川内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 特許業務法人 Y K I 国際特許事務所 (**YKI INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS**); 〒1800004 東京都武蔵野市吉祥寺本町一丁目 3 4 番 1 2 号 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JO, JP, KE, KG, KH,

(54) **Title:** DEVICE AND METHOD FOR MANUFACTURING SEMICONDUCTOR DEVICE

(54) 発明の名称: 半導体装置の製造装置および製造方法



(57) **Abstract:** A device for manufacturing a semiconductor device comprises: a stage (12); a bonding head (14); a following mechanism (22) mounted on the bonding head (14); and a controller (34) that executes an adjustment process. In the adjustment process, after putting the following mechanism (22) in a lock state, the controller (34) brings a facing surface (50) of the bonding head (14) into contact with a reference surface (110) of the stage (12), and after switching the following mechanism (22) to a free state, presses the facing surface (50) against the reference surface (110), and then switches the following mechanism (22) back to the lock state.

[続葉有]

WO 2021/241095 A1

KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY,
MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ,
NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT,
QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,
ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,
US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

- 国際調査報告 (条約第21条(3))

(57) 要約: 半導体装置の製造装置は、ステージ(12)と、ボンディングヘッド(14)と、ボンディングヘッド(14)に搭載された倣い機構(22)と、調整処理を実行させるコントローラ(34)と、を備え、前記コントローラ(34)は、前記調整処理において、前記倣い機構(22)を前記ロック状態にしたうえでボンディングヘッド(14)の対向面(50)をステージ(12)の基準面(110)に当接させた後に、前記倣い機構(22)をフリー状態に切り替えたうえで前記対向面(50)を前記基準面(110)に押し付け、さらに、その後、前記倣い機構(22)を前記ロック状態に切り替える。